

## 陕西省半导体行业协会拜访三星（中国）半导体

7 月 4 日，陕西省半导体行业协会秘书长何晓宁一行拜访了三星（中国）半导体有限公司，三星半导体经营管理常务/副总裁申在镐、企划次长/总监权泰一和财务总监李文刚接待了协会来访，并对协会的拜访表示欢迎。

何晓宁秘书长介绍了协会和国家集成电路设计西安产业化基地的概况，诚挚邀请三星（中国）半导体加入陕西省半导体行业协会。何晓宁还将国家集成电路制造企业认定的相关事宜进行了说明，并对三星目前的投产及项目建设情况进行了关心询问。申在镐表示三星对集成电路制造企业认定非常重视，希望在协会的帮助下能尽快通过认定，对三星目前在西安的项目进展和建设情况进行了介绍，同时就三星加入协会事宜将尽快汇报总部后给予答复。最后何晓宁秘书长表示欢迎三星来协会和基地参观，加强双方的互动和交流。此次拜访将为双方今后的长期合作与发展奠定了良好的基础。

## 西安航天华迅成功中标省级北斗卫星行业应用项目

7 月 8 日，陕西省半导体行业协会会员单位西安航天华迅科技有限公司成功中标“陕西省公安系统警务用车卫星定位管理系统”项目。陕西省公安系统警务用车卫星定位管理系统项目是陕西省大力实施“科技强警”战略的重要组成部分，更是我国公安系统警务用车管理领域首个省级北斗应用项目，具有极高的示范推广效应。该项目将为陕西全省公安机关各类警务用车累计安装北斗定位车载终端超过一万台，系统建成后将实现陕西省各级公安机关警务车辆基于北斗导航定位的统一监督管理，规范全省公安系统的警务用车行为，全面提高陕西省警务用车的使用效率。

该项目自 2013 年 10 月立项以来，航天华迅公司迅速响应，以专业的项目研发管理团队，先进的项目建设方案以及多年来所积累的技术优势从十多家竞标企业中脱颖而出，最终在陕西省公安厅组织的公开招标中获得了用户和专家评委的一致认可，综合总分排名第一。

该项目的成功中标是航天华迅公司自去年 8 月加入航天科工集团以后，全面推进航天融合取得的重要成绩，也是航天华迅公司在谋求企业转型升级之路上取得的重大突破，极大的提高了航天华迅公司在国内北斗导航领域的行业地位，同时也为提升集团在陕西省乃至西北地区以及国家北斗产业的影响力作出了新的贡献。

来源：西安航天华迅科技有限公司

## 陕西省半导体行业协会举办新三板专题讲座

经过陕西省半导体行业协会在本年度第一、第二季度的调研走访，部分企业表示要更加深入的对新三板进行了解，有些企业对新三板已经产生了浓厚的兴趣。

8月5日上午，陕西省半导体行业协会举办了新三板专题讲座会，协会邀请了陕西亚成微电子股份有限公司余远强董事长做专题讲解，西安华芯等11家会员单位参加了本次讲座，讲座会由协会常务副理事长邱义路主持。

陕西亚成目前是我省唯一新三板上市的集成电路设计企业，余董事长就新三板上市的政策、流程和规则、上市过程中存在或遇到的问题，以及上市后所给企业带来的利益和弊端等相关问题展开讲解，同时余董事将亚成上市的成功经验与大家进行了分享。参加会议企业负责人和代表就各自关心的问题进行了询问，余董事长对问题一一进行了详细解答，讲座现场气氛和讨论非常热烈，达到了预期的效果。

## 西安交通大学暑期实习圆满结束

2014年6月30日到7月18日，西安市集成电路产业发展中心受西安交通大学（电信学院微电子学系）委托，与微电子学系2011级本科生生产实习带队老师一起组织实施暑期实习活动。

本次活动包括产业环境的学习、C++在IC上的应用等专业知识讲座、参观西安华新联合科技有限公司、西安永电电气有限责任公司、陕西天宏硅材料有限责任公司、西安西谷微电子有限责任公司、华天科技（西安）有限公司等代表性企业。活动还进行了为期10天的功率元器件工作原理培训。通过从此实习让同学们动手完成相对应的实验作业，在知识应用于实践的基础上，提高了动手的能力。中心邀请了安西安华芯半导体有限公司、西安亚成电子有限公司、英特尔移动通信技术（西安）有限公司、西安中兴通讯股份有限公司，四家代表性企业代表与同学们面对面进行交流，耐心回答学生们对今后学习、工作的困惑，使以后学习更有针对性和目标。

通过此次实习活动，发挥了西安市集成电路产业发展中心的引导作用，使同学们更加全面的了解西安集成电路产业，并对今后就业方向有了更加明确的定位和目标。

## 西部最大智能终端生产基地落户西安高新区

7 月 25 日,西安高新区管委会与中兴通讯股份有限公司签署投资协议,宣布中国西部最大的智能终端生产基地落户西安高新区。这不仅标志着西安高新区已经逐步形成完整的智能手机产业链,也标志着西安高新区打造千亿元智能终端产业形成龙头企业引领发展态势。

省长娄勤俭、副省长李金柱、西安市市长董军、省政府秘书长陈国强等省市领导出席签约仪式,中兴通讯董事长侯为贵、中兴通讯执行副总裁曾学忠等共同出席。

签约前,省长娄勤俭会见了中兴通讯公司董事长侯为贵一行。娄勤俭说,今年以来,在经济下行压力加大的情况下,陕西经济指标总体较好,特别是非能源产业增长位列全国第三位,充分表明我省优化产业结构取得良好效果。中兴智能终端生产项目落户西安是我们发展新兴产业、加大结构调整力度的又一成果,是中兴通讯为陕西发展作出的重要贡献。我们将一如既往地支持中兴在陕发展,积极帮助企业解决实际问题,为项目建设创造良好环境。

侯为贵表示,中兴十分看好在陕发展前景,将抓紧落实合作协议推动项目早日建成,为陕西经济又好又快发展再添新力。

此次签约的中兴通讯西安智能终端生产基地,一期将达到年产 1500 万部智能终端,是中兴通讯也是中国西部最大的智能终端生产基地,项目建成后年产值和销售收入均为 100 亿元。协议签订一年内实现在西安生产。中兴通讯西安智能终端生产基地将采用业界领先的全自动生产线,涵盖从单板测试加载、全自动化分板点胶、整机音频测试、整机软件加载等全流程自动化生产,进一步提升中兴智能终端产品质量一致性和生产效率。

在智能终端产业领域,西安高新区具有良好的产业发展基础。三星、中兴、华为、酷派等龙头企业纷纷落户西安高新区,设立研发基地和分支机构,对西安智能手机产业链产生了重要的辐射带动作用。中兴通讯将最大的智能终端生产基地落户于此,正是看中了西安高新区得天独厚的区位优势以及极具吸引力的产业政策导向。而事实上,西安工厂的建设已不是中兴通讯与西安市的第一次合作,早在 2006 年,中兴通讯就与西安高新区达成协议投资建设中兴通讯西安研发基地,目前该基地已成为西部最大的研发中心之一。

来源: 陕西日报

## 三星环新（西安）汽车动力电池项目西安开工建设

8月18日上午，三星环新（西安）汽车动力电池项目在西安开工建设，这是我省与韩国三星集团务实合作的又一硕果，标志着西安将成为全国最大的汽车动力电池生产基地。省长娄勤俭宣布开工。省委常委、常务副省长江泽林，西安市市长董军，三星SDI社长朴商镇，韩国驻西安总领事全哉垣，三星大中华区总裁张元基以及有关客户代表分别致辞，并为项目培土奠基。

汽车动力电池项目由三星SDI公司与安庆环新集团、西安高科集团合作建设，总投资6亿美元，其中一期2.99亿美元，于2015年4月建成后可月产70万枚电池芯，2020年前二期规划完成后将达到月产360万枚电池芯。经过对全国多个城市的反复对比，今年1月三星SDI公司最终确定在西安建设该项目。省市有关方面切实搞好服务，短短的半年时间里，项目的申报核准、规划选址、土地供应、环境影响评价等前期工作顺利推进，再次体现了“陕西速度”和“西安效率”。

江泽林代表省委、省政府对项目开工表示祝贺。他说，三星环新动力电池项目的启动建设，对于陕西在现有良好基础上进一步完善产业链条，尽快将新能源汽车产业打造成支柱产业，加快构建独具特色的现代产业体系具有重要意义，也必将促进三星和环新公司优化生产布局，实现自身跨越发展。陕西将为包括三星、环新在内的所有企业在陕发展创造良好环境，提供优质服务，努力实现互利共赢。

董军在致辞中说，三星环新动力电池项目落户西安，必将对我市乃至全省加快发展新能源汽车产业，加速实现产业转型升级、全力打造新的支柱产业，起到重要的支撑作用。他表示，西安市将全力为项目建设创造良好的外部环境，积极协调解决工程建设中遇到的困难和问题，以更加务实的举措、更加扎实的作风、更加优质的服务，确保项目顺利实施、早日建成投产。

朴商镇在致辞中说，西安历史悠久、充满文化气息，是中国科技实力雄厚和西部大开发的核心城市。三星SDI与安庆环新集团把全球第一的电池技术与汽车配件领域的经验相结合，将生产出拥有最高性能和最好品质的汽车用动力电池。相信西安公司在不久的将来会成为中国最好的生产基地、全球最好的汽车电池工厂，成为备受瞩目的“新能源丝绸之路”的重点。

来源：西安晚报

## 我省初步形成北斗卫星全产业链 双模导航芯片 定位精度 2.5 米芯片正式量产

目前,我省北斗卫星产业已初步形成从理论研究到应用服务的全产业链。所生产的北斗/GPS 双模导航芯片在服务覆盖区域实现了精度 2.5 米的定位。

我省共有 50 余家企业和机构从事北斗卫星产业,涉及航天动力、测控、卫星设计、空间材料、空间应用等航天专业领域全国重点高等院校 5 所,国家级重点实验室 12 个,科研人员逾万人,已初步形成从理论研究到应用服务的全产业链。

“近日,在陕航天企业成功研发出第四代高性能北斗/GPS 导航芯片,在北斗导航覆盖区域可实现精度 2.5 米的定位,俘获灵敏度、跟踪灵敏度等各项性能指标达到国际领先水平。”相关专家介绍,依托北斗导航系统,未来几年,西安的农场里将有无人驾驶的飞机在播种,庄稼的成长情况由机器来监控;容易发生地质灾害的路段将有监测点时时进行观察,记录石块儿的移动方向和距离。这些都会变成现实。

来源:西安晚报

## 第 11 届海峡两岸信息产业和技术标准论坛在西安举行

8 月 21~22 日,第 11 届海峡两岸信息产业和技术标准论坛在西安举行。论坛由中国电子工业标准化技术协会、中国通信标准化协会和华聚产业共同标准推动基金会共同主办,陕西省政府承办。国务院台湾事务办公室、工信部、国家发改委、国家新闻出版广电总局、国家标准化委员会等有关部门以及两岸信息产业界代表、专家学者共 500 余人参加了论坛。

开幕式由国务院台湾事务办公室副主任龚清概主持,陕西省人民政府省长娄勤俭、华聚产业共同标准推动基金会董事长陈瑞隆、中国通信标准化协会理事长邬贺铨致辞。工信部副部长毛伟明做了题为《推进融合发展,实现合作共赢,共同谱写两岸信息产业合作的新篇章》的主题演讲。工信部总工程师周子学做了专题演讲。

大会期间,公布了《LED 视觉作业台灯》、《电子纸显示器件光学性能测试方法》、《晶体硅光伏组件用减反射镀膜玻璃规范》等半导体照明、平板显示技术及太阳能光伏 3 个领域的 10 项共通标准,签署《海峡两岸推动锂离子电池共通标准合作备忘录》、《海峡两岸推动传感器领域标准研究及产业合作备忘录》、《海峡两岸推动云计算共通标准制定及产业协作合作备忘录》、《海峡两岸推动 4G/TD-LTE 第二阶段共通标准制定合作备忘录》4 个备忘录。

来源:中国电子报

## 西安高新区打造千亿元智能终端产业集群

7月25日,西安高新区管委会与中兴通讯股份有限公司签署投资协议,宣布中国西部最大的智能终端生产基地落户西安高新区。

其实,中兴带给西安的,远不止是一个生产基地。中兴通讯生产项目的落户,将使西安高新区跨入国内重要智能终端生产基地行列,而这个项目更重要的意义在于,借助与中兴通讯的联姻,西安高新区整个智能终端产业链也有了新的血液,为陕西、西安电子信息产业的发展提供了强有力的支撑,同时也积蓄了强大的发展后劲。

在当下建设丝绸之路经济带的进程中,陕西的产业转型升级正在进行,信息产业已成为推动陕西经济增长的新引擎。西安高新区千亿智能终端产业集群的加速崛起,使得陕西、西安经济发展的内生动力不断增加,并将继续增强。

### 通信行业龙头企业纷纷落户高新 智能手机产业聚集度不断增强

以通信产业为代表的电子信息产业是西安高新区的四大主导产业之一,也是西安重点发展的战略产业之一。2013年,高新区通信产业实现营业收入850亿元,共有通讯产业相关企业和增值服务等机构400多家,从业人员5万余人,通信企业数量在全国高新区名列前茅。同时,西安高新区是科技部确定的“国家通信高新技术产业化基地”和“国家军民融合通信创新型产业集群试点园区”。当前,西安高新区已聚集华为、中兴、宇龙酷派、TCL、爱立信、三星、英特尔等众多国内外著名企业,形成了较为完整的通信产业链和初具规模的产业集群。特别是4G技术商用步伐的加快,使西安高新区有望成为全国第二大通信产业基地。

在智能终端产业领域,西安高新区已吸引了三星、中兴、华为、酷派等龙头企业纷纷落户,设立研发基地和分支机构,对西安智能手机产业链产生了重要的辐射带动作用。在中国智能手机市场份额前十名的企业中,三星、华为、中兴通讯、宇龙酷派等企业都已在高新区有重大投资。其中,韩国三星电子一期投资达70亿美元的高端存储芯片项目以及投资5亿美元封装测试项目已落户高新区,其中三星存储芯片项目今年5月已经实现量产,封装测试项目正在加紧建设,这将极大地带动关联产业集群发展,为西安智能手机产业链提供强有力的推动作用。

在智能手机研发方面,华为公司在西安的研发人员已突破万人,其中手机研发人员千余人,与手机研发相关的外包人员过千人,相对应的研发机型的手机出货量在数千万部。中兴通讯研发人员已近万人,其中手机研发人员4000人,是公司的手机研发总部,涵盖了智能手机与功能手机几乎全部的机型,对应的研发机型出货量约6000万部。宇龙酷派、TCL、手机ODM龙头企业闻泰集团、手机设计领军企业龙旗控股、手机整体方案领先企业华勤集团、锐嘉科集团均已在西安设立研发中心,对应的手机出货量过亿部。另外手机芯片设计方面,有高通、英特尔等企业在西安高新区也有重要

的研发布局。

智能手机制造和配套企业方面，宇龙酷派目前已将其第二生产基地布局西安高新区，已吸引了一部分核心配套企业共同投资西安，加上此次签约的中兴智能终端生产项目，使得西安高新区在智能手机产业聚集度不断增强，也将对高新区手机产业链的形成起到开创性的引领作用。

### 凭研发优势让制造扎根 智能终端全产业链日趋完善

近年来，西安高新区着力发展新一代信息技术等战略性新兴产业，吸引了众多国内外著名企业进驻，使得高新区在信息技术产业领域形成了高度聚集优势。进驻高新区的高端产业，所看重的正是高新区乃至西安市良好的产业发展基础与健全的产业链配套环境。然而，完善产业链并非一日之功。多年来，西安高新区抢抓机遇，采取招大引强战略，智能手机产业规模日益壮大，在产业链的各个关键环节，都闪烁着国际国内知名大企业的名字英特尔、华为、中兴、TCL……共同铸就了高新智能手机产业链的枢纽，带动配套企业相继尾随而至，带动本土企业发展，已初步形成了较为完整的通信产业链和初具规模的产业集群。

在这个链条上，高新区在终端智能研发方面可谓是极尽优势，三星、中兴、华为、酷派等龙头企业纷纷落户，设立研发基地和分支机构，智能终端研发人员已突破万人，相对应的研发机型的手机出货量过亿部，产值近千亿元。这对西安智能手机产业链产生了重要辐射带动作用。

研发如此集中，如果生产能在西安就近布局，那么，对于手机企业而言，就能够获得快速交付、快速出货的一系列优势。目前，宇龙酷派已确定将其第二生产基地布局西安，已吸引部分核心配套企业共同投资西安。此次中兴通讯又将智能终端生产项目落户西安高新区，将进一步加快相关企业和配套企业在西安聚集，为打造千亿元智能终端产业链奠定了坚实的基础，有利地带动全市工业转型升级和集群化发展，实现中兴通讯效益提升和地方经济发展的双赢。

与此同时，我省目前也制定了《围绕三星项目加快配套产业发展规划》，强调要充分发挥研发优势，以研发带制造，以设计促集成，着力打造智能手机产业的高端企业聚集区和制造研发一体化区。

### 10 亿元专项资金 全方位扶持 助力高新智能手机产业迈向“千亿级”

西安地处中国版图中心，交通便利，加上西部大开发战略的持续推进，国家鼓励通信产业向中西部转移、大力发展内需市场。同时，西安是我国重要的通讯和集成电路产业教育研发基地，拥有通信类国家级科研机构 30 多个，各类专业技术人员 44 万人，科技人员密集度排在全国前列，微电子、通信、软件等相关专业人才供应充足。这些都为智能手机产业链的快速发展提供了基础条件。

为引导智能手机企业在高新区加速集聚，推动智能手机产业链做大做强，加快推进智能终端产业集群发展，西安高新区于去年就已经发布《西安高新区关于扶持智能

手机产业链发展的若干政策》，计划拿出 10 亿元专项资金，打造千亿级智能手机产业集群。政策提出，凡在高新区投资设厂的智能手机整机制造和关键元器件生产企业，投资强度和容积率达到相关要求的，都将给予政策扶持。同时对在高新区生产的智能手机，以及在高新区创立自主品牌的，将给予物流补贴。此外，还将对有关企业给予房租补贴、知识产权资助、新增产值奖励等政策支持。这一政策的出台，极大地激发了国内外智能手机产业企业投资高新区的积极性。

同时，西安高新区还依托西安及高新区在通信、软件、文化创意等产业的已有基础，以专业化的智能手机产业园为承载，大力推进关联产业的聚集、集成和融合，实现产业链的全方位、立体化、多层次发展模式；积极培育和引进龙头骨干企业，形成以龙头骨干企业为支点、大中小企业紧密配合、专业分工与协作完善、具有国际国内市场竞争力的产业集群；依托西安及高新区在智能手机研发方面的已有优势，大力引进和培育智能手机制造和生产配套企业，最大程度地推动高新技术与制造工艺的深度融合。

在园区规划建设方面，高新区依托中兴通讯、宇龙通信、华为及三星电子等龙头企业，规划建设通信产业园，为智能手机产业提供有力承载。目前，一期 7 平方公里已全面启动。下一步将继续加大龙头企业招引力度，招引手机产业链上下游合作企业抱团投资、整体移植，加快智能手机园区的全面建设。

与此同时，结合三星项目建立快速干道和航空出口渠道的有利时机，加快智能手机产业物流体系的建设，为产业链的延伸和强化提供强有力的物流基础设施支持。并进一步加大产业环境培育力度，夯实园区基础环境，加大软环境优化力度，为智能手机产业链建设提供最佳发展环境。

西安高新区将通过三到五年的发展，建立智能终端产业链，着力打造智能手机产业的高端企业聚集区、前沿技术创新集中区和制造研发一体化区，使我省成为世界最重要的智能手机产业聚集地之一。最终达到年生产 2 亿部手机，终端直接产值千亿元以上（不含配套），力争占有中国智能手机市场份额的 30%，占有全球智能手机市场份额的 15%。每年新增就业人口 5 万人。

来源：西安晚报

## 《西安市加快培育科技企业小巨人三年行动方案 (2014-2016 年)》政策解读

6 月 23 日，《西安市加快培育科技企业小巨人三年行动方案（2014-2016 年）》（市政发〔2014〕20 号，以下简称《行动方案》）正式印发，明确了我市在统筹科技资源改革示范基地建设加快推进阶段的主要任务。近日，市科技局对此进行了解读。

**1.问：什么是西安科技企业小巨人？**

**答：**近年来，上海、天津、深圳等城市先后把培育科技型中小企业作为促进城市经济转型发展的一项重要任务，分别提出了培育科技企业小巨人的工作目标。我市在充分借鉴其他城市经验做法的基础上，结合西安发展实际，把创新能力强、成长速度快、市场前景好，年销售 5000 万元以上的科技型中小企业称为科技企业小巨人。也就是说，在未来 3 年内，经过发展能达到上述标准的科技型中小企业，都将纳入支持范围。

**2.问：出台《行动方案》的背景和意义是什么？**

**答：**党的十八大、十八届三中全会明确提出，实施创新驱动发展战略，把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，强调要发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用。科技型中小企业创新意识和创新动力强、运营机制灵活、市场反应迅速，在创新机制和创新效率方面具有很强的优势，是技术与市场有机结合的重要载体，在中小企业群体中，最具发展潜力和成长性。经过多年的发展，我市目前拥有科技型中小企业总数 1 万多家，整体发展势头良好，已经成为转化技术成果、发展新兴产业、扩大社会就业的有生力量。基于以上考虑，市政府决定把培育科技企业小巨人，作为深化统筹科技资源改革的载体，落实创新驱动发展战略的突破口，促进科技与经济紧密结合的主要抓手，对于发挥西安科技资源优势，增强民营经济活力，优化我市产业结构、促进经济提质增效具有十分重要的意义。

**3.问：《行动方案》提出总体要求和目标的依据是什么？**

**答：**首先是落实市委市政府关于“两块短板求突破”、促进经济提质增效的决策部署。其次是结合西安科技型中小企业发展现状，目前，我市在规上工业企业及限额以上服务企业中，科技企业超过千家，其中销售收入过亿元的 347 家，5000 万元-1 亿元的 308 家，2000-5000 万元的 410 家，无论是技术水平，还是市场占比，全市科技企业都具有广阔的发展前景。基于对全市科技型中小企业发展形势的判断，《行动方案》提出，到 2016 年，全市科技企业小巨人总数超过千家，销售收入超过千亿元，科技型中小企业总数达到 1.5 万家，形成“千企千亿带万家”的发展格局，并在平台建设、产业发展等方面，明确了具体的目标任务。

**4.问：我市培育科技企业小巨人的基本思路是什么？**

**答：**坚持分类推进、多手段支持的工作思路，针对不同发展阶段的科技型中小企业，以打造小巨人企业为重点，通过市场机制整合科技资源和政策资金措施，引导创新链、资金链向企业和产业聚焦，大幅提升科技型中小企业对全市产业发展的支持和引领作用。具体地讲，对销售收入过亿的科技企业，重在提升企业核心竞争力和市场开拓能力；对规模以上企业，重在突破企业快速发展中的人才、技术、资金等瓶颈问题；对创业企业，重在完善扶持政策体系、加强创业服务平台建设，激发全社会创业热情。

**5.问：如何理解对领军企业的支持措施？**

**答：**领军企业指销售收入亿元以上，技术水平世界一流、市场占比国内领先、示范带动作用明显的科技型中小企业。打造百家领军企业，主要是通过实施专项工作计划，落实政策聚焦和一企一策，推动其更快发展；通过支持企业自建或与高校院所联建研发中心等措施，提升企业技术创新能力；通过支持企业突破一批核心技术，形成重大创新产品，带动产业链上下游企业配套协作，提升企业产品创新能力；通过组织专业服务机构帮助企业制定发展战略等措施，提升企业市场开拓能力。

**6.问：如何把握发展壮大优势企业的支持重点？**

**答：**年销售收入2000万元以上科技型中小企业，最主要的发展瓶颈是技术、人才、资金三个方面的问题。《行动方案》聚焦企业实际困难，分别制定了具体措施。在技术转移方面，主要是支持企业转化高校院所技术成果；在人才服务方面，组织千名科技人才解决企业技术难题，鼓励高校院所将技术转移纳入职称评价体系，完善企业引进高端人才的支持政策；在拓宽融资渠道方面，重点是依托市级科技金融服务平台，利用科技金融合作资金，引导金融机构创新金融产品，加大信贷投放力度，扩大知识产权质押贷款、信用贷款、助保金贷款等业务规模，解决小巨人企业融资难题。

**7.问：市上对支持创办科技企业的主要措施有哪些？**

**答：**支持人才创新创业，是激发城市创新活力、扩大社会就业的重要手段。《行动方案》提出：一是继续支持国家“千人计划”、省“三秦人才”、“百人计划”和海内外高层次留学人才、高校院所创新团队创办科技企业；二是通过举办西安创新创业大赛，建设创新创业社区，加大对初创企业的扶持力度，降低创业成本；三是以高新区、经开区为主，大力发展完善创新创业孵化体系，建立各类载体运营绩效考核和补贴机制，提升其服务创业能力；四是加强科技招商引智引资，支持国内外高校院所、知名企业以及外籍工程师、留学归国人员在我市创办科技企业。

**8.问：“千企千亿带万家”中“带万家”的任务如何实现？**

**答：**通过培育科技企业小巨人，带动万家企业创新发展，提升我市民营经济发展活力，促进区县产业转型升级、新兴产业快速发展，是《行动方案》的最终目的。

在带动中小企业创新发展中，一个是通过延长完善产业链条，配套带动现有科技企业创新发展；另一个是支持传统企业技改升级，加快向科技型企业转变。在带动区县科技产业园区提升发展中，按照“一类一策”的原则，每年投入5000万元，重点支持阎良、碑林、户县、雁塔等区县产业园区建设，促进渭北工业区、副中心城市和中心城区创新发展。在带动科技服务业快速发展中，主要是落实国家现代服务业综合试点任务，用好中省资金，支持以研发设计、检验检测、技术转移、科技文化融合为重点的科技服务业快速发展。

**9.问：市上将采取哪些方式解决科技企业发展中的融资难题？**

**答：**市政府对科技金融结合非常重视，批准成立西安科技金融服务中心，设立了

专项资金。作为营造创新环境的一个重要手段，我们将不断完善科技信贷风险补偿机制、创业投资激励机制、科技保险补贴机制，建立市区县及产业开发区联投联动机制，有效降低企业贷款成本和风险，推动企业快速发展。市财政资金 3 年累计投入 28 亿元，撬动信贷资金 80 亿元，吸引各类投资突破 100 亿元，为科技企业小巨人发展提供资金保障。

**10. 问：在强化企业知识产权能力建设方面有哪些具体举措？**

**答：**强化知识产权能力建设是提高企业自主创新能力的的重要手段。一是建立维权援助体系，加大专利执法力度，最大限度保护企业合法权益；二是重点推进《企业知识产权管理规范》贯标工作，不断提高企业知识产权创造、运用和管理能力；三是帮助企业开展专利信息分析利用，降低研发成本，提升研发效率，规避创新风险。

**11. 完善科技型中小企业创新服务体系的重点是什么？**

**答：**实践表明，加强以西安科技大市场为中心的科技公共服务平台建设，对于完善创新服务体系、促进成果转化至关重要。下一步，我们将继续提升西安科技大市场服务功能，围绕技术交易和设备共享，建设专业支撑平台；围绕分析检测、制造资源、工业品采购，建设市场化运营平台；围绕政策推送、技术供需对接，建设移动互联平台。加快实现从信息化平台向市场化平台的转变。到 2016 年，技术成果交易额达到 800 亿元，共享设备达到 1 万台套，加盟专业服务机构 500 家。

**12. 问：与以往相比，培育科技企业小巨人的支持方式有哪些变化？**

**答：**主要体现在两个方面。一个是由重单个项目技术水平的评判，向对企业整体创新发展能力的评判转变，小巨人项目实行“先备案、后申报”和动态管理的工作机制，要求企业在备案时应提交三年发展规划，突出了企业自主创新的主体作用，更加强调产学研协同创新。另一个是优化财政资金投入方式，由过去的以无偿资助为主，逐步过渡到后补助、奖励、补贴、股权投资等多种形式，更加注重财政资金的杠杆撬动作用，吸引更多的社会资本培育科技企业小巨人。

**13. 问：如何推动《行动方案》有效落实？**

**答：**按照市上统一部署，一是加大宣传力度，围绕政府做什么、怎么做和企业有什么发展目标等重点，利用多种手段组织宣传推广，营造全社会认识、理解、支持培育科技企业小巨人的浓厚氛围。二是强化服务意识，进一步细化政府内部的任务分工和责任落实，形成分工明确、重点突出、高效联动的工作机制，出台一批务实管用的政策措施，真心实意地为企业做好服务工作。三是促进银企结合，以深化科技金融结合为重点，出台专项工作方案，引导金融机构服务企业发展，最大限度帮助企业解决融资难题。四是创新体制机制，认真落实全面深化改革的总体要求，以平台共用、人才培养、队伍建设为重点，推动全市各个行业、系统和机构间的互动对接，有效解决我市科技资源分散、分隔、分离的问题，促进科技与经济紧密结合。

来源：西安市科学技术局

## 2014年中国集成电路产业主要政策法规

自2000年以来,我国政府颁布了一系列政策法规,将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一,大力支持集成电路行业的发展,主要如下:

《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号):首次专门针对软件和集成电路产业制定了鼓励政策,对集成电路行业的发展具有重要意义。

《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号):明确和细化了税收方面的具体鼓励政策。

《集成电路布图设计保护条例》(中华人民共和国国务院令(第300号)):为保护集成电路布图设计专有权,鼓励集成电路技术的创新,促进科学技术的发展,对集成电路布图设计的权利、登记和行使等方面作出了规范。

《集成电路布图设计保护条例实施细则》(国家知识产权局局长令(第11号)):针对《集成电路布图设计保护条例》的实施进行了细化。

《集成电路设计企业及产品认定管理办法》(信部联产[2002]86号):对集成电路设计企业及产品的认定指定了统一的规范标准。

《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》(财建[2005]132号):针对集成电路产业研究与开发专项资金管理进行了规范。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》(国发[2005]第044号):将高端通用芯片定为16个国家科技重大专项之一。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号):提出着力发展集成电路、高端服务器等核心基础产业。

《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号):从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等七个方面为集成电路产业发展提供了更多的优惠政策。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》:出大力发展新一代信息技术产业,其中重点发展集成电路等产业。

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》:指出集成电路为优先发展的高技术产业化重点领域。

《集成电路产业“十二五”发展规划》:作为我国集成电路行业发展的指导性文件和加强行业管理的依据,对“十二五”期间集成电路产业的发展指明了方向。

《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》:提出重点发展集成电路设计,其中着重提高高端通用芯片等设计能力,形成系统方案解决能力。

《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税的通知》(财税[2012]27号):对符合条件的集成电路生产企业、集成电路设计企业提供了企业所得税方面的优惠政策。来源:中商情报网

**半导体**

## 2014 年上半年中国集成电路产业运行情况

根据中国半导体行业协会统计, 2014 年上半年中国集成电路产业销售额为 1338.6 亿元, 同比增长 15.8%。其中, 设计业继续保持快速增长态势, 销售额为 428.2 亿元, 同比增长 29.1%; 制造业销售额 326.2 亿元, 同比增长 6.8%; 封装测试业销售额 584.2 亿元, 同比增长 12.6%。

根据海关统计, 2014 年上半年进口集成电路 1302.9 亿块, 同比增长 1.6%; 进口金额 988.1 亿美元, 同比下降 17.1%。出口集成电路 680.8 亿块, 同比下降 4.6%; 出口金额 279.5 亿美元, 同比下降 47.6%。

来源:中国半导体行业信息网

## 2014 年上半年集成电路进出口数据

据海关总署统计, 2014 年 1-6 月份我国集成电路进口额为 992.62 亿美元, 比 2013 年同期减少 15.4%, 出口额为 280.75 亿美元, 比 2013 年同期下降 46.5%; 7 月份进口额为 184.48 亿美元, 出口 63.58 亿美元。

来源:中国半导体行业信息网

## 2014 年全球半导体销售额近 3360 亿美元

近日数据显示, 2014 年全球半导体销售业绩将达到 3360 亿美元, 较 2013 年成长 6.7%, 高于上一季所预测的 5.4%。Gartner 研究副总裁 Bryan Lewis 表示, 2014 年半导体的成长广泛分散在各芯片类型及应用, 相较于 2013 年仅有 0.8% 之增幅, 2014 年非存储器领域将劲扬 5.2%。

来源:中国半导体行业信息网

## 大陆蓝宝石厂近两月投资扩产 58 亿 全产业链望共享盛宴

近期, 大陆厂商纷纷投巨资对蓝宝石项目进行扩产。天通股份 6 月 27 日晚间公告称将募集资金约 20 亿元将用于智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目, 生产蓝宝石晶体、晶片以及相关窗口材料产品。露笑科技 4 月 1 日公告称与伯恩光学共同出

资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司，伯恩露笑公司拟计划总投资 20 亿元人民币。拟上市公司蓝思科技计划募集资金 54 亿元，其中 18 亿元用于蓝宝石生产及智能终端应用。

分析人士指出，大陆厂商大规模扩产蓝宝石盖板，将有利于蓝宝石全产业链的发展，使得全产业链共享盛宴，这些企业既包括上游的蓝宝石坩埚厂家，也包括下游的切割、加工企业。

安泰科技：公司主要的产品包括蓝宝石生产用钨坩埚和热场，目前已形成单月 300 个坩埚与 60 套热场的产能配置，钨坩埚占公司主要坩埚产品的比重达到 90% 以上。自 2013 年下半年开始公司接手订单开始增加，截止 2014 年一季度公司基本接近满产水平。

大族激光：公司立足激光设备生产领域，在十多年里成功发展了一条包括激光打标机、焊接机、切割机、制版在内的激光产业链，产品覆盖珠宝钻石、仪器仪表、汽车配件等众多下游行业。早前有消息传出，大族激光的首批蓝宝石盖板激光切割机已获得苹果公司约 2000 万美元首批订单，相关人士未予正面回答。

水晶光电：国内光学冷加工行业的龙头企业，过去主要生产应用于光学镜头的各类红外截止滤光片、低通滤波器等产品。自 2010 年以来持续投入蓝宝石切磨抛加工行业，品质在业内具有良好口碑。

铜峰电子：公司主要从事蓝宝石晶棒切割、打磨、抛光工作，基于过去在石英晶体上的加工经验，目前的加工水平较好。公司 2013 年 12 月 19 日公告对三科电子的增资 1000 万元，进一步强化蓝宝石加工产能。

华工科技：公司蓝宝石切割设备处于中试阶段，目前还没有正式用于客户。

来源:大智慧阿思达克

## 移动智能终端市场生变 国产芯片厂商扩大低端市场份额

根据 IDC 最新发布的《中国智能终端市场季度跟踪报告（2014 年一季度）》，2014 年一季度中国智能终端市场（包括 PC，平板电脑，智能手机）出货量约为 1.2 亿台，环比上升 8.4%，同比上涨 24.1%。IDC 数据显示，芯片厂商中联发科在智能终端市场份额一路上涨，2014 年一季度达 34.6%。尤其在中低端市场（300 美元以下），联发科的份额在 50% 左右。位列第二的高通在中高端市场（100 美元及以上）依然保持明显优势。在高端市场（300 美元及以上），高通、英特尔、AMD、苹果等传统知名芯片厂商纷纷汇聚于此。IDC 中国终端系统研究部高级研究经理武止戈表示：“《国家集成电路产业发展推进纲要》的推出将有助于国产芯片厂商扩大其在低端智能终端市场的份额，市场竞争格局也将进入变革期。”

### 1. 展讯在低端市场(100 美元以下)的份额达 24.1%

展讯借助中国移动 TD-SCDMA 生态系统市场抢占市场份额，通过与本土厂商合作在入门级产品市场进行竞争，今年一季度其在低端市场的份额达到 24.1%。从 2013 年开始，展讯研发并推出了 HSPA 芯片用以拓展 HSPA 市场，目前市场销量增长比较明

显。此外，借助中国移动在 4G 市场的推广，展讯会继续在 TD-LTE 市场发力。

2.4G 在智能手机占比迅速增长，其中高通占比达 32.1%

随着 2013 年 12 月 4G 牌照的发放，4G 智能手机出货量迅速增长。一季度 4G 智能手机出货量达 661 万部，在智能手机的市场份额达到 6.4%。政府大力推进 4G 手机，预计 2014 年出货量将达到 1.2 亿部，市场占比达 27.5%。在 4G 市场中，高通借助其技术优势和对市场节奏的把握能力，已在第一时间与 OEM 厂商合作量产 4G 产品进入了中国市场。2014 年一季度，高通在 4G 手机的市场份额达到 32.1%。

3.英特尔发力移动智能终端市场

英特尔通过其在芯片领域的品牌影响力在平板电脑市场发力，一季度其在平板市场份额增至 5.3%，同比增长显著。同时，英特尔通过补贴的形式扩大了其中低价位段移动芯片市场的份额，并推动自身生态系统的构建。这将有助于英特尔在移动芯片领域市场份额的继续提升。此外，微软将在下半年推出 500 和 800 元两档平板电脑，这一利好使英特尔平板更具竞争力。

4.四核成为智能手机主流产品，八核产品快速增长，占比远超全球平均水平

在智能手机市场，四核手机的份额较去年同期的 9.4% 有了快速增长，到 2014 年一季度已占据了 49.7% 的市场份额，远高于全球 35.6% 的平均水平。这主要是因为中国市场已是各芯片厂商的必争之地，市场竞争非常激烈，产品更新换代速度加快，并且在 OEM 的宣传下中国消费者对成熟的四核手机认可度较高。以上诸因素使得四核产品得到快速普及。

来源:元器件交易网

## 智能电源管理芯片市场分析

1、平板电脑和智能手机产业的快速发展推动全球智能电源管理芯片市场规模的增长：便携式智能互联终端，尤其是新生的平板电脑和智能手机产业的快速发展推动了智能电源管理芯片市场规模的增长。2013 年，全球智能电源管理芯片的出货量达到 9.8 亿颗，销售额到达 17.2 亿美元。未来几年，全球智能电源管理芯片在智能终端的快速增长下仍有望保持较高的增长。预计 2016 年，全球智能电源管理芯片的出货量达到 14.3 亿颗，销售额到达 22.5 亿美元。

2、中国市场智能电源管理芯片市场规模不断扩大：从国内市场看，中国市场智能电源管理芯片 2013 年的出货量达到 6.5 亿颗，销售额到达 62.5 亿元。预计 2016 年的出货量有望达到 10.2 亿颗，销售额有望达到 90.8 亿元。

TI（德州仪器）是模拟集成电路领域的世界级领先企业，发布了大量针对电源管理的器件。根据 2013 年的统计数据，德州仪器在中国智能电源管理芯片市场占有率为 23.4%，位居第一；此外，DialogSemi、ST、Qualcomm、全志等企业位居 2013 年中国智能电源管理芯片市场的前五位。

来源:中国半导体行业信息网

## 指纹识别芯片市场概况

指纹辨识晶片因为苹果(iPhone)的 iPhone5S 开始采用而成为市场大热门产品,众多 IC 设计公司抢进。苹果先前购并了指纹辨识晶片大厂 Authentec, 因此相关零组件可以由内部自行供应; 其他非苹阵营的手机品牌业者则必须另觅适合的合作夥伴。日前, 另一家指纹辨识晶片供应商 Validity 又被触控大厂 Synaptics 收购, 显示指纹辨识产业正陆续进行整合, 但市场上也有不少新面孔。

目前有能力供应指纹辨识晶片的 IC 设计公司包括 FPC、Validity、神盾科技、联发科投资的汇顶、茂晖、敦泰、义隆电等。FPC 是瑞典的指纹辨识供应商, 成立于 1998 年, 专利为电容式指纹辨识技术, 与大陆各大银行的指纹识别系统合作多时, 目前专攻手机的指纹辨识技术, 客户包括多加大陆系统厂, 如华为、富士通、康佳、联想。

来源: DIGITIMES

## 台积电、三星 FinFET 各拥新欢 海思实力上浮

积电大客户高通(Qualcomm)传出首颗 FinFET 制程手机芯片, 可能先下单给三星电子(Samsung Electronics)后, 传出在台积电内部, 华为成为第一家量产 FinFET 制程的手机芯片客户, 出现台积电和三星在下世代 FinFET 制程技术上, 更拥新欢的有趣现象, 半导体产业上、下游竞争同样激烈。

华为旗下的海思半导体成立于 2004 年, 是集团内最神秘的一块业务, 但却悄悄超过手机芯片业者展讯, 成为大陆第一大的 IC 设计公司。

目前海思的营收几乎都来自于华为贡献, 海思不仅为华为打造芯片核心, 同时也为协助华为创造硬体的差异化, 强化系统品牌竞争实力, 这样合作模式现在也备受全球复制。

放大海思营收几乎都来自于华为贡献, 同时也为协助华为创造硬体差异化。法新社半导体业者分析, 虽然海思的手机芯片也有对外销售, 但比重很小, 主要是过去海思都不把半导体部门作为一个冲刺销售或营收的业务部门, 而是全球协助华为的产品竞争力, 尽量淡化其独立芯片供应商的角色, 但未来是否仍是如此内敛低调, 恐怕不然。

根据市调机构 IC Insights 统计, 2013 年海思排名全球第 12 名, 营收为 13.55 亿美元, 较 2012 年第 13 名再迈前一步, 年增长率为 15%, 展讯为 14 名, 年营收为 10.70 亿美元, 全球龙头高通年营收为 172.11 亿美元, 第二名的博通年营收为 82.19 亿美元, 联发科排名全球第四名, 年营收为 33.66 亿美元。

全球手机芯片市场也正在面临洗牌战, 博通先宣布退出手机基频芯片市场, 海思近期在发表 Kirin920 芯片, 满足市场 8 核心和 4G 的要求后, 等於是技术实力又再迈前

一步。

尽管业界评估，华为旗下的 IC 设计大厂海思半导体实力，距离高通和联发科仍有相当大的距离，但大陆半导体厂有政府银弹奥援，有广大市场和需求作后盾，连高通行走大陆市场都要畏惧官方三方，屡次被控垄断市场。

更为了拉拢大陆官方，传出高通也配合政府策略，到大陆晶圆代工厂中芯国际投片 28 纳米制程。

陆厂为了抢第一，颇具土豪式的企图心。从华为传出抢下台积电 16 纳米 FinFET 制程头香，更配合台积电后段 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)服务，抢下全球第一颗 FinFET 制程芯片，可见具备完整规划和强烈野心，在 FinFET 制程导入上胜过高通和联发科。

有趣的是，过去手机芯片的半导体新制程都是高通和台积电配合，这次上下游合作夥伴大风吹，高通将拥抱三星第一款 14 纳米 FinFET 制程，华为成为台积电第一个 FinFET 制程客户，算是半导体使上头一遭，未来如何牵动上下游版图，值得进一步专注。

晶圆代工厂表示，客户有强烈企图心，对上游晶圆代工厂是好事，否则若都没有客户愿意尝试新制程，晶圆代工厂即使具备最好的新技术，也没有人愿意协助试产，等于英雄无用武之地。

来源:digitimes

## A 系列芯片订单让苹果成为台积电最大客户

iOS 产品在全球范围内的持续火热不仅为苹果带来了巨额的收入，同时也让苹果合作伙伴的未来充满了活力，台积电正是这样的一家厂商。威锋网消息，根据一份来自供应链的报导，苹果即将成为台积电(TSMC)的最大合约客户，双方最主要的合作项目就是 A 系列芯片的生产封装。

报导称，虽然台积电没能获得三星电子的 14 纳米高通芯片订单，但是他们有很大机会从苹果的 A9 芯片订单当中分到一杯羹。不过，《路透社》上周曾在一篇报导当中透露，苹果很有可能选择三星作为其 14 纳米芯片的供应商，而不是此前所报导的台积电。《路透社》表示，三星将会在 2015 年下半年开始为苹果出货 14 纳米的芯片。

iPhone 在上一季度的销量为 3520 万台，iPad 则是 1330 万台。也就是说，上一季度苹果一共卖出 4850 万台采用 A7 芯片的设备，这个数字对于未来 A8 芯片的订单是一个重要的参考数字。按照目前的情况来看，三星和台积电在未来几年之内仍将是苹果 A 系列芯片的最大供应商。

来源:威锋网

## 10 多家大陆 IC 设计公司向台积电下 28nm 芯片订单

8月5日消息,据台湾电子时报报道,来自业内的消息,超过10家IC设计和IC设计服务公司已在台积电下了28nm芯片订单,表明大陆IC供应商竞争力日益增强。

该消息称,这些向台积电下28nm芯片订单的中国IC设计公司包括海思半导体、展讯通信、瑞芯微电子、全志科技、锐迪科及大唐。

此前,大陆IC设计公司主要依赖中芯国际和和舰科技代工低成本产品芯片用于国内市场。

该消息补充说,大陆IC设计公司已经开始引进先进工艺来提升他们芯片的性能,用于移动设备、电信设备、4G智能手机、物联网设备和其他有商机的应用中。

除了联发科的订单,大陆IC设计公司在台积电的订单量已超过了台湾本土IC厂商。

来源:元器件交易网

## 集成电路装备制造业现状及问题解读

6月24日国务院正式批准的《国家集成电路产业发展推进纲要》中指出了要突出“芯片设计-制造-封测-装备材料”全产业链的布局。中国已经是全球集成电路市场的大国,但集成电路大量依赖进口。要将我国集成电路产业做大做强,就一定要把我国集成电路装备制造业搞上去。

### (一)我国集成电路装备制造业现状

1、在国家科技重大专项的支持下,一些大规模集成电路关键装备通过验收并走进了大生产线

极大规模集成电路制造装备及成套工艺科技项目(简称02专项),2008年-2013年共安排集成电路装备研制项目29项,到2013年底已验收12项,这些装备也走进了12英寸极大规模集成电路的生产线。

### 2、国产集成电路先进封装生产线关键设备产业化进展迅速

国产集成电路先进封装生产线关键设备得到了集成电路生产厂商的信任和认可,实现了产业化。其中有集成电路先进封装用匀胶机、3微米步进式投影光刻机、用于三维芯片封装的硅通孔刻蚀机、高密度深硅等离子刻蚀机、TSV硅通孔物理气相沉积设备(PVD)等,这些关键装备的国产化有力地推进了我国集成电路先进封装产业的发展。

### 3、国产集成电路硅片生产设备尚未进入产业化

在02专项的支持下,12英寸集成电路硅片生产设备(硅单晶生长炉、多线切割机、磨片机、抛光机)目前的γ机已通过工艺认证,但尚未进入大生产线。

## (二)我国集成电路装备制造业存在的主要问题

### 1、市场占有率低

目前,我国大规模集成电路生产线装备大都依赖进口,我国大规模集成电路生产线(8-12 英寸)中的硅片和晶圆(芯片)制造装备大都是依赖进口的(8 英寸以下的生产线是引进翻新的二手设备),这不仅严重影响了我国集成电路产业的发展,也对我国电子信息的安全造成重大的隐患。根据中国电子专用设备工业协会对我国 13 家主要集成电路生产单位的统计,2013 年共销售集成电路设备 1093 台,销售金额 10.34 亿元(其中芯片制造设备约 7 亿元),大约是当年我国半导体设备进口额的 5%左右。

### 2、产业化进程缓慢

“十二五”期间,尽管在国家重大专项的支持下,一些关键设备进入了大生产线,并经过了验收,但在新建的生产线上,使用单位有较大的风险,在与进口设备的竞争中,国产设备很难挤得上去。特别是对大规模集成电路芯片制造设备国产化缺乏信心,使已经在生产线上验收的国产设备产业化进程艰难。目前,一些设备制造单位,已经将集成电路设备成果应用到风险相对低的 LED 等其它半导体器件领域。

### 3、缺乏“领军”的高技术人才

一些技术难度大的关键设备,由于缺乏“领军”的高技术人才,久攻不下,同时也影响了集成电路生产线设备国产化的推广。

## (三)我国集成电路装备制造业发展设想

1、对国家投资的集成电路建设工程项目,要提出集成电路生产线设备国产化的要求,推广已经在集成电路大生产线上验收过的国产设备。

2、依托国家科技专项集成电路关键装备科技项目,对承担项目的单位设备产业化目标要提出更高的要求,进一步推进集成电路产业化的进程。

3、鼓励和支持积极使用国产集成电路设备的集成电路生产企业,对使用首台(套)集成电路关键设备给予优惠政策,以减少承担的风险。

### 4、建设国产化集成电路示范生产线,推进我国产集成电路产业做强

没有国产的集成电路生产线,仅依赖进口集成电路设备的集成电路产业是不可能做强的,只能跟在人家后面跑,并且还要受制于人,所以建设国产化示范生产线是当务之急。从目前的市场需要和我国集成电路设备发展情况来看,建议在二到三年内建设以下三条集成电路国产化示范生产线:12 英寸集成电路硅片生产线;集成电路先进封装生产线;8 英寸 90nm 集成电路晶圆(芯片)生产线。

来源:中国电子报

## 中国光伏行业协会成立

6月27日，中国光伏行业协会成立大会在北京召开。全国政协副主席马培华、工业和信息化部副部长杨学山出席成立大会并发表讲话，同时为中国光伏行业协会揭牌。会议由工业和信息化部电子信息司司长丁文武主持。国家发改委、科技部、民政部、财政部、国土资源部、环保部、住建部、商务部、中国人民银行、国家质检总局、银监会、证监会、国家能源局、国标委、国家开发银行等部门，北京、江苏、浙江、河北等省市工业和信息化主管部门，中国机电商会、中国可再生能源学会等行业组织，中国光伏行业协会成员及新闻媒体代表近300人参加了会议。

马培华在讲话中指出，近年来我国光伏产业取得优异成绩，成为具有国际竞争力的战略性新兴产业，但同时也面临国际贸易争端常态化、并网发电机制有待健全、产能过剩仍然存在等突出问题，机遇和挑战并存。建立健全具有影响力的国家级行业协会，有利于形成合力，加强行业内部交流及国际交流，实现行业规范自律，推动光伏产业健康发展。

杨学山在讲话中指出，中国光伏行业协会的成立是中国光伏产业发展进程中一件具有里程碑意义的大事。他对中国光伏行业协会今后的工作提出三点希望：一是协会要代表行业整体发展的诉求；二是要服务行业，起到纽带、桥梁、平台的作用，推动行业自律、技术创新，组织企业应对国际贸易争端，建立信息平台；三是协会要加强自身建设。

中国光伏行业协会筹备组组长王勃华介绍了中国光伏行业协会前期筹备情况。民政部民间组织管理局副局长刘振国宣读了《民政部关于中国光伏行业协会筹备成立的批文》，并宣布协会正式成立。中国机电产品进出口商会会长张钰晶代表行业组织宣读贺信。

中国光伏行业协会是根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》的精神，按照我国光伏业界的自发意愿，由光伏产业上下游企事业单位积极发起成立的。

来源：中国电子报、电子信息产业网

## 我国率先实现 LED 白光技术 定位精度达 1 米

当越来越多的 SHOPPINGMALL 超过 10 万平方米时，当越来越多的大型室内空间都面临着空间大而监控不足的情况时，当曾经我们辅以重任的 WIFI、蓝牙等传输的室内定位系统频频出现较大误差时，人们开始寻求更加合理，更顺应未来发展趋势的室内定位技术。

LED 灯的快速普及令可见光通信技术(LED 白光通信技术)成为了最新最具期待的室内定位技术,解决了曾经困扰所有室内定位技术定位精度超过 5 米的难题,首次将定位精度限定在 1 米!

无论是国外还是国内的技术先锋们,都聚焦于 LED 白光室内定位技术,但唯有我国率先完成了从技术到商业化的过程。

华策光通信科技有限公司,作为和国家半导体照明创新实验室合作的项目,自主研发出来基于 LED 白光定位技术的 U-beacon 室内定位系统,使用 CMOS 摄像头进行可见光信号接收,不同于使用感光二极管接收可见光,弥补了其它国家在可见光信号接收方面易受周边其它光源干扰的不足。且在今年中旬实现了商业化运营,推出了全球首个具有 3D360 实景地图的应用 APP——易逛,并已经在江苏常州市开始了试运营。

这仅仅是初始阶段。对于 WIFI 和蓝牙定位,使用可见光来进行定位,不但初始安装费用低,而且不需要像 WIFI 和蓝牙那样重新扫描信号强度,后期维护成本也低,加上定位精度的优势,人们对于可见光通信的未来更加看好。不仅仅是技术上的提升,更多是应用层面的多维度呈现。

LED 灯具和智能手机,这是实现可见光通信的两大硬件,硬件上的大规模普及在一定程度上给了 LED 室内定位技术智能化发展的更多可能性。在专业的技术人员和运营专家们看来,该技术的运用不仅仅在商业领域里,还将呈现于多个行业内,其未来的发展有着不可忽视的前景。

来源:OFweek 半导体照明网

## LED 芯片发展速度超国外 数据一片看好

近几年,随着我国 LED 产业的快速发展,我国外延芯片产业规模也取得了显著增长。2006 至 2013 年间,产值规模增长 10 倍,年均复合增长率超过 30%,明显快于国际同期水平。尤其是在 2010 年后,随着我国外延芯片产能的集中释放,产业规模迅速扩大。2013 年,我国芯片环节产值达到 105 亿元,增幅 31.5%。

2013 年随着 MOCVD 产能继续释放而使 LED 芯片产量大幅增长 61%,达到 2805 亿颗。其中 GaN 芯片全年产量为 1800 亿颗,增幅为 58.5%。随着通用照明市场的加速启动,预计 2014 年以后整个芯片市场产量规模将快速增长,增速将保持 50%左右。

来源:中国半导体照明网

## 中国电子专用设备工业协会金存忠:MOCVD 国产化迈出一大步

目前,我国中晟光电设备(上海)有限公司、中微半导体设备(上海)有限公司等企业已经成功攻克生产LED外延芯片的关键设备—MOCVD,并在2013年进入大生产线,实现了MOCVD销售6腔的业绩,向国产MOCVD产业化迈出了一大步。这不仅摆脱了长期依赖国外进口的被动局面,也降低了LED芯片制造的成本。

在LED上、下游生产线设备中,蓝宝石晶体生长炉、多线切割机、研磨机、抛光机、清洗甩干机、匀胶显影设备、ITO溅射台、刻蚀机、PECVD、AIN PVD、激光划切机、点测机等国产设备也都进入了大生产线,国产设备的高性价比赢得了越来越多LED生产企业的欢迎。如北京北方微电子生产的干法刻蚀机和沈阳芯源生产的匀胶显影设备在国内市场的占有率都已达到60%。

根据中国电子专用设备工业协会对国内7家LED设备制造商的统计,2013年LED设备销售收入达到5.05亿元,出口交货值540万元。而今年1~6月已实现销售收入3.26亿元,出口交货值达到576万元。

目前国产LED生产线设备存在的主要问题是设备可靠性和智能化、自动化有待提高。

来源:中国电子报

## 北京出台城市景观照明技术标准

日前,北京市市政市容委就北京市地方标准《城市景观照明技术规范》系列标准(以下简称《规范》)征求意见。《规范》拟规定,景观照明中严禁使用强力探照灯、大功率泛光灯,并对住宅、公寓、医院病房等建筑的干扰光做出严格规定。此外,居民家中如果受到路灯或者广告霓虹灯等光污染的困扰,可打电话向管理部门反映。

《规范》要求,景观照明在设计时应充分考虑景观周边环境情况。在住宅周边的景观照明设施不得影响居民的正常休息,应控制朝居室的灯具亮度。在机动车道路周边设置景观照明时,不得设置投向驾驶员视线方向的LED灯具。市民对《规范》如有建议,可于8月28日前以电子邮件或传真的方式向市市政市容委反馈。

来源:中国电子报

**物联网****物联网领域再现新联盟 与微软 LG 抗衡**

根据国外媒体报道,近日三星、英特尔和戴尔公司宣布建立一个非营利性“开放互联联盟”(Open Interconnect Consortium),旨在为诸如温控器、智能电灯等互联网设备建立统一标准和认证。

开放互联联盟的建立,旨在将工作重点先放在家居和办公场所的物联网设备,然后扩展至汽车等其他领域。除了三星、英特尔和戴尔之外,OIC 的成员还包括 Atmel 公司、博通公司及 Wind River 系统公司,未来数月还将加入更多成员。而该联盟将会与高通、LG 电子和其他公司支持的全视联盟(AllSeen Alliance)进行正面对抗。而无论是哪个联盟,它们都是为了建立统一的标准,帮助智能家电设备通过物联网连接起来。

在物联网的潮流下,尽管智能家居的产品层出不穷,但是问题在于,由于电器间涉及到跨品牌、跨平台、跨设备之间的无线通讯,智能家电往往是各行其是、互不兼容。英特尔软件和服务集团总经理 Doug Fisher 表示,新联盟制定的框架可以解决 AllSeen 联盟处理不好的安全问题和其他问题。他认为制造商使用两组不兼容标准生产的智能家庭产品不大可能出现。

AllSeen 联盟中不乏知名厂商,LG、夏普、海尔、松下、HTC、Silicon Image、TP-Link、思科等,涵盖了处理器厂商、网络基础设施商、路由器厂商、家庭终端厂商等。而就在上周,微软成为了 AllSeen 联盟的第 51 个成员。

高通的高级副总裁 Rob Chandhok 将这两个相互竞争的标准团体,比作上世纪 90 年代初在互联网普及前相互隔离的在线服务。“我们最好有行业共享的平台而非分离,我不想成为物联网中的 Prodigy 和 CompuServe(美国原先三大联网公司中的 2 家)。” Chandhok 表示。从现在的状况来看,当物联网的阵营形成后,大的格局是统一,但阵营之间仍然是分裂。

来源: 新浪科技

**物联网将引发芯片行业另一个黄金年代!**

从 2014 年上半年的销售记录来看,半导体的销售情况持续走高,行业内部对今后的销预测持积极态度。

半导体行业协会(SIA)称全球芯片制造商在本年第二季度收入总计 827 亿美元,比上年同期增长了 10.8%。今年前六个月销售额比去年上半年同比增长了 11.1%。

在 2013 年度，全球半导体芯片行业收入已经达到 3056 亿美元，增加了 5%，这标志着芯片制造商去年年度利润达到历史峰值。

SIA 总裁兼首席执行官 Brian Toohey 表示：现在存在很多积极地因素足以帮助大多数类型的芯片制造商涉足目前所需的所有领域。

个人电脑的销售是许多芯片的主要目标市场。不过在经过长时间的折腾，这些生产商已经将部分资金转入到平板电脑方面，同时，使用各种各样类型的芯片的智能手机市场需求也同样保持强劲。

Toohey 说到：除了那些已经成立的类别，在汽车行业领域芯片的需求量增长迅速，医疗器械行业和 Silicon Valley 所说的“物联网”都需要大量芯片的供应。“物联网”这一术语，指的是为很多日常的设备添加传感器和计算通信能力，其中包括灯泡、门锁和恒温器。

芯片行业在 2008 年和 2009 年期间遭受了巨大的衰退。在 2010 年销售情况反弹迅速，但依旧略低于之前水平。2012 年再次上升，并在 2013 年创造历史记录。

Toohey 同时还指出：芯片行业在 2015 年到 2016 年期间还会再迎来一次上涨。

来源：猎云网

## 2014 物联网新产品发布会隆重召开

8 月 14 日，由国际物联网贸易与应用促进协会(IIPA，简称国际物促会)主办、深圳市物联传媒有限公司协办的“2014 物联网新产品发布会”在深圳会展中心 2 号馆隆重举行。

林总称，这款 RFID 专业标签不仅采用防转移铝蚀刻天线及专用胶水，同时还采用了特殊胶水复合工艺，局部不残胶，既能实现标签一拆即坏，又解决了胶水不易清理的问题。

记者在现场获悉，除了上述几家企业外，世麦智能、玺瑞股份、旭龙物联、永奕科技、骄冠科技等纷纷推出了各自在物联网领域的新产品，并收到了广大业内人士的诸多好评。

而据记者提前获得的消息，在明日的物联网新产品发布会现场，还将有亿道电子、鼎识科技、艾特姆、赢达聚力、万全智能、捷通科技、思创汇联、子博、金瑞铭、斑马、摩天射频、孚恩电子、富立叶微电子、九点动力等企业代表纷纷出席并为大家分享其在物联网里的各种新产品、新技术及解决方案。

来源：赛迪网

## 创维海思合推国产智能电视芯片量产 中国电视缺芯少屏时代结束

近日，创维与海思联合推出应用了中国首款具有自主知识产权并实现量产的智能电视芯片的 GLED 电视。创维集团董事、彩电事业本部总裁刘棠枝表示，这标志着中国彩电业“缺芯少屏”时代的结束。

刘棠枝说，这是中国第一颗自主研发的智能电视芯片，在创维的电视产品中第一次应用，“也是我们跟海思申报获批的国家‘核高基’项目可以量产的第一个产品，量产级别十万级”。工信部电子信息司副司长刁石京表示，这是首款中国自主研发并量产的智能电视芯片，对提升中国彩电业的核心竞争力具有里程碑意义。

深圳市海思半导体有限公司（简称海思）终端芯片研发管理部部长王稷告诉《第一财经日报》记者，这款国产智能电视芯片的配置为“4 核 CPU8 核 GPU2 核 VPU”，电视开机时间只需 15 秒，“不逊色于台积电 28 纳米的智能电视芯片”。

海思终端芯片显示领域总经理罗琨向本报记者透露，海思与创维联合申报并获批的“核高基”项目，代号为“2014-核高基 6-3”，是 2013 年 5 月申报，6 月答辩，7 月获批的。一旦按创维计划，应用了这款国产智能电视芯片的 GLED 电视在明年 3 月底前达到 30 万台的销量，罗琨说，“这个‘核高基’课题就可以结案了”。王稷还透露，这款国产智能电视芯片是由中芯国际生产的。而中芯国际集成电路制造（上海）有限公司中国营销一部总监罗宇则表示，海思是中芯国际最大的中国客户，双方一直深度合作。

“这款芯片从设计、生产、封装到下游终端产品应用，全部在中国完成”，王稷说。据刘棠枝介绍，过去国产电视的芯片都是台湾或其它国家生产的，没有中国芯片。创维注重彩电技术创新，海思又是国产芯片龙头企业，所以双方联合申报“核高基”项目，为国产彩电业终结“缺芯少屏”状况而强强联合。

经过一年多努力，现在看到这个“核高基”项目商业化的阶段性成果。刘棠枝说，“这款芯片比同类型芯片成本节省 20% 以上，GLED 的 4K 智能电视也比同类型产品价格低 8%-10%。”

尽管这款芯片的知识产权属海思，刘棠枝表示，希望继创维之后，这款国产智能电视芯片也能被其它国产彩电品牌应用，“我们有先发优势，不担心同行竞争”。

刘棠枝看好智能电视的游戏、购物及未来的广告收入潜力，但他认为，彩电企业向互联网转型，“如果转型转亏本，是不负责任的。所以，转型、创新、变革，应在对股东、员工、国家社会负责的基础上转型，才是科学的转型，才是好的转型。”

事实上，GLED 的 49 英寸产品卖 6999 元，55 英寸卖 9999 元。而目前普通的 55 英寸 4K 电视只需 5000-6000 元。刘棠枝说，高端的 55 英寸 4K 智能电视一般上万元，这些才是 GLED 比拼的对象，而 GLED 相比之下更具性价比。

来源：一财网。

## 中科大量子集成光学芯片研究达国际最高水平

记者7月18日从中科大获悉,该校郭光灿院士领导的中科院量子信息实验室任希锋研究组在量子集成芯片研究上获得新进展,他们在量子集成芯片上成功实现单个表面等离子激元的量子干涉,且其干涉可见度达95.7%,这是迄今公开报道的国际最高水平。成果日前发表在著名期刊《物理评论A》上。

集成光学芯片,具有尺寸小、可扩展、功耗低、稳定性高、信号传输速度快等诸多优点,在光学仪器等经典光学中已获得广泛应用。表面等离子激元,就是局域在金属表面的一种由自由电子和光子相互作用形成的混合激发态。近年来,表面等离子激元作为新的信息载体,已被引入量子信息领域,其优势是将能量束缚在亚波长尺寸的波导中传播,从而能进一步提高集成光学芯片的集成化程度。然而,表面等离子激元波导结构中实现的量子干涉的可见度小于50%,且存在固有损耗,这两大问题一直困扰着等离子激元的应用研究。

中科大研究人员利用亚波长表面等离子激元波导结构,成功实现单个表面等离子激元的量子干涉,可见度达到95.7%,为在量子信息处理过程中应用表面等离子激元解决了若干关键性难题。研究证实,其固有损耗会对量子干涉可见度产生影响,但通过特殊设计,能使这种影响降低到可以接受的程度,这将对进一步研究表面等离子激元量子信息过程起到指导作用。

来源:安徽日报

## DNA 芯片密码系统进入实用阶段 未来将大有作为

从中国科学院华南植物园获悉,该院科研人员解决了从DNA芯片制作与探针合成到实际操作的过程中存在的各种难题,使得DNA芯片密码系统能够立即进入实用阶段。其提供的技术方案为DNA芯片的应用开辟了一个崭新的巨大市场,未来在信息安全领域将大有作为。

由华南植物园曾纪晴、张明永等科研人员完成的“一种基于DNA芯片的密码系统”获国家发明专利授权。

由于DNA芯片的高度集成性,人们也开始探索DNA芯片应用于密码学领域。但每一条消息加密或解密过程都必须特别制作一张DNA芯片,成本巨大,信息传递效率极低。缺乏可操作性或操作成本太高,远远不能进入实用阶段。

“一种基于DNA芯片的密码系统”发明采用随机DNA序列制作DNA芯片,只需批量生产同一种DNA芯片,批量合成芯片上对应DNA的探针,无需对每一条秘密信息进行DNA芯片的特制。信息发送方也只需要使用上述预先批量合成的探针进行不同的配比混合,就可以传送不同的秘密信息,而信息接收方只需要使用同一款的DNA芯片就可以接受不同的秘密信息。

据介绍,该发明从DNA芯片制作与探针合成到实际操作的全过程,完全解决了

之前存在的各种难题，使得该密码系统能够立即进入实用阶段。

来源:中新网

## 国产高性能导航芯片研发成功 填补国内空白

近日，由中国电科集团重庆声光电公司自主研发的 XN235 卫星导航芯片，其性能与国外同类型先进产品一致，但省电一倍以上，而且能够同时兼容 GPS（全球标准）、BD（中国标准）、GALILEO（欧洲标准）三种导航模式，使用本芯片的导航产品可实现全球通用，畅游无阻。该芯片经鉴定达到国际先进水平，填补了国内高性能导航芯片方面的空白。据了解，该芯片已获国家发明专利 1 项，集成电路布图登记 3 项，并在多个领域实现了应用。

目前全球仅推出的三款卫星授时产品之一——北斗授时手表，已采用该芯片作为核心芯片，手表的时间与我国标准时间能保持精确同步，其时间精度可控制在 0.1 秒内。

来源:中国证券网

## 英特尔推最小 3G 芯片 比小一分钱钢镚

英特尔日前宣布推出堪称世界上最小的 3G 网络芯片模块，其大小和一美分硬币差不多。据悉，这款芯片的代号为 XMM6255，整体面积仅为 300 平方毫米。别看人家个头下，但却很有内涵。除了内嵌电力供应装置之外，还特别对芯片过热等极端条件下的运行进行了很多优化。分析人士指出，随着这种超微型化芯片的推出，将有利于推进物联网的发展。很显然，在移动芯片领域颜面扫地的英特尔，在积极追赶的同时，已经为下一波科技浪潮的到来做好的准备。

来源:pv-tech

## 第十二届中国国际半导体博览会暨高峰论坛

2014年10月28-30日·上海新国际博览中心N1馆

展会背景：“中国国际半导体博览会暨高峰论坛（ICChina）”经过11年的发展，已成为国内外具有一定影响力的半导体业界盛会。“ICChina”为从事集成电路设计、芯片加工、封装测试、半导体专用设备、半导体专用材料、半导体分立器件的海内外厂商，企事业单位搭建了一个展示最新成果，打造产品品牌的平台。“十二五”是半导体产业发展的重要机遇期。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，为半导体产业发展带来发展机遇和动力。市场推动产业发展，应用引领技术创新，由中国半导体行业协会、中国电子器材总公司、上海市经济和信息化委员会共同主办的“ICChina2014”将以“应用驱动、快速发展”为主题，力邀国内外优秀半导体企业参展、参会；精心组织物联传感、智慧城市、汽车电子、医疗电子、可穿戴电子、移动终端等新兴产业成果展示，共同推进系统应用—半导体—专用设备、材料全产业链的发展。

展会主题：应用驱动 快速发展

展览时间：2014年10月28日~30日

展览地点：上海新国际博览中心N1馆

展览范围：IC设计与产品、IC设计工具及服务、芯片制造、封装测试、半导体专用设备与零部件、半导体材料、集成电路应用与解决方案、半导体分立器件、半导体光电器件、功率器件、传感器件、IC分销、物联网、智慧城市、智能家居、便携终端、汽车电子、LED、健康医疗等IC应用类。

联系方式：中国半导体行业协会

联系人：徐贞华、任振川、孙亚东、刘学军

电话：010-68207449 / 68207450 / 68207456 / 68207455 / 68208589

传真：010-68154708

中电会展与信息传播有限公司

联系人：贺琼华、潘煜枝

电话：010-51662329

传真：010-68236719

陕西省半导体行业协会

联系人：刘颖、赵城

电话：029-88328230

传真：029-88316024